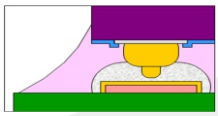
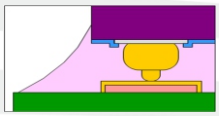
Flip Chip / Gold Stud Bump

Deux techniques d'assemblage pour la miniaturisation de circuits haute densité



ICA

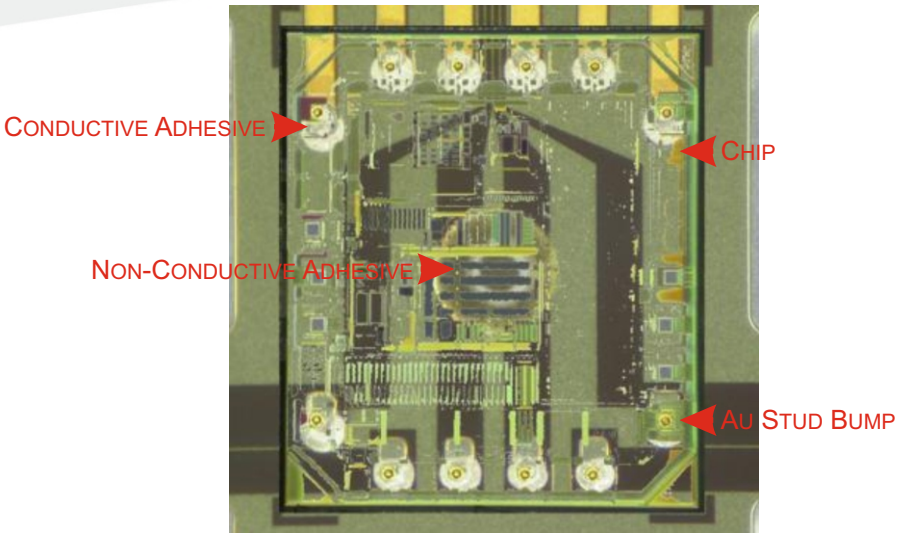
Isotropically Conductive Adhesive (+Underfill)



NCP

Non-Conductive Paste

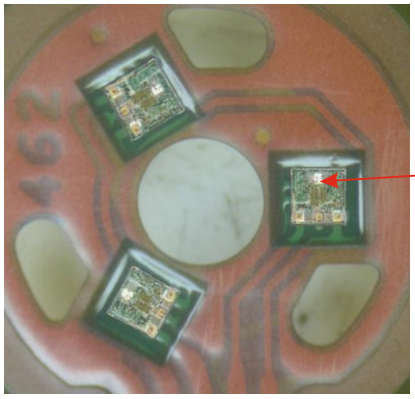
ICA / Isotropically Conductive Adhesive



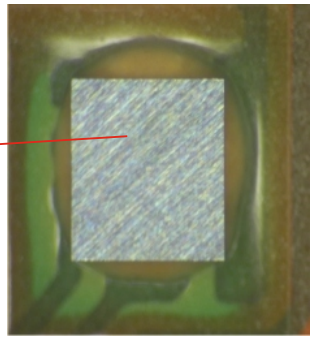
Vue en transparence

Hybrid SA est à même de réaliser un assemblage Flip-Chip sur des modules électroniques selon des spécifications définies en collaboration avec le client. Pour une bonne manufacture, il est important d'être partenaires, en particulier dans le design du layout.
Un assemblage Flip-Chip permet à nos clients une miniaturisation accrue de leur module en réduisant au strict minimum l'encombrement des composants.

NCP / Non-Conductive Paste



Vue en transparence



Non-Conductive Paste après Thermocompression

HYBRID SA CH-2025 Chez-le-Bart Tel.: ++41 (0)32 835 33 88 E-mail: mailbox@hybrid.swiss https://www.hybrid.swiss